

Global Leading Company  
with World's Best Technology

# LEENO



# DISCLAIMER

---

이 자료에 포함된 당사의 재무성과에 대한 모든 정보는 한국의 기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.

또한, 이 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이러한 예측정보는 이미 알려진 또는 아직 알려지지 않은 위험과 불명확성에 따라 영향을 받으며, 실제 결과와 이에 기재되거나 암시된 내용 사이에 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

향후 **전망은 현재의 시장상황과 당사의 경영 방향 등을 고려한 것으로 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 확인**해야 합니다. 실시간 기업정보는 저희 홈페이지 <https://leeno.com/kr> 을 통하여 확인 할 수 있습니다.

의문점이나 요청사항이 있을 경우, 아래의 정보를 이용하면 신속한 조치를 받을 수 있습니다.

리노공업 주식회사

책임자 : 최용기 (051)-831-3232

담당자 : 김진철 (051)-831-4931 [jckim@leeno.co.kr](mailto:jckim@leeno.co.kr)

**LEENO** LEENO IND. INC.

---

## I. Business Description

- 01. 회사소개
- 02. 경쟁력
- 03. 주요 고객사

---

## II. 사업 분야

- 01. LEENO PIN
- 02. IC TEST Socket
- 03. Probe Head(Card)
- 04. Secondary Battery Test Pin
- 05. Ultrasonic Wave Probe Component

---

## III. Financial Highlights

- 01. Stock Information
- 02. Year Performance
- 03. Dividend
- 04. Financial statement

---

## IV. Appendix



# 회사 소개

## LEENO

회사명	리노공업주식회사
CEO	이채윤
설립일	1978년 11월 (법인전환 1996년 12월)
주요 생산품	반도체 테스트용 PROBE PIN 및 SOCKET
자본금	76.2 억원 ('24)   76.2 억원 ('25.2Q)
매출액	2,782 억원 ('24)   1,909 억원 ('25.2Q)
직원수	636 명 ('24)   644 명 ('25.2Q)
주소	부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10
홈페이지	<a href="https://leeno.com/kr">https://leeno.com/kr</a>



## 주요약력

- 2001. 12. 코스닥 신규등록 승인 및 거래개시
- 2003. 10. 대통령직속 중소기업특별위원회 표창장 수상 (제694호)
- 2004. 12. ISO 9001 인증 취득  
11. 지역혁신 우수사례 국무총리상 수상
- 2005. 9. 한국경영생산성대상 및 우수기업 선정 (제2005-204호)  
11. 무역의 날 1,000만불 수출의 탑 수상
- 2006. 11. ISO 14001 인증 취득
- 2007. 1. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 기업 선정 (제7021-4호)  
7. 2007년도 부산중소기업인 대상 수상 (제1122호)
- 2010. 1. 지멘스와 초음파 진단기용 프로브 부품 공급계약 체결  
11. 무역의 날 2,000만불 수출의 탑 수상
- 2011. 1. 부산광역시 전략산업(IT) 선도기업 선정
- 2012. 1. ISO13485 인증 획득
- 2013. 5. World Class 300 선정  
6. 무상증자  
8. 본사 확장이전  
12. 무역의 날 3,000만불 수출의 탑 수상
- 2014. 3. '제41회 상공의 날' 석탑산업훈장 수훈 (제2980호)
- 2016. 3. '제50회 납세자의 날' 표창 수상 (인사 제2016-285호)  
12. 무역의 날 5,000만불 수출의 탑 수상
- 2017. 12. 무역의 날 7,000만불 수출의 탑 수상
- 2020. 2. 녹산공장(의료기기,표면처리) 준공
- 2021. 12. 무역의 날 1억불 수출의 탑 수상
- 2022. 12. 무역의 날 2억불 수출의 탑 수상
- 2023. 12. ISO 45001 인증 취득
- 2024. 11. 제9회 명문장수기업 선정

# 경쟁력

다품종 소량 주문생산 및 최단의 납기에 적합한 생산시스템 보유



Consistent, Quality Products



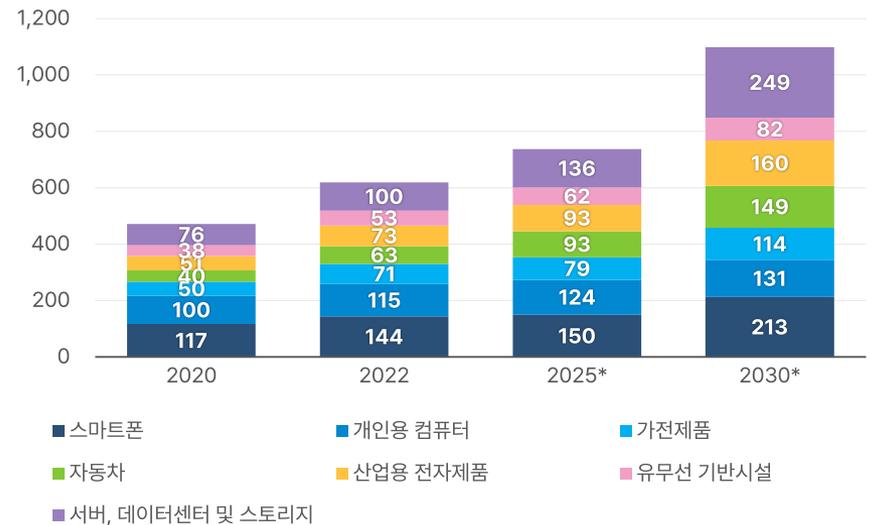
# 주요 고객사



## 반도체 APPLICATION별 시장규모

(시장규모: USD십억)

출처: Statista(2023년 2월)



Statista는 2030년까지 반도체 Application별 시장 규모를 상기와 같이 전망하고 있습니다. 2030년에는 스마트폰 2,130억불, 서버/데이터센터/스토리지 2,490억불, 개인용 컴퓨터 1,310억불, 자동차 1,490억불, 산업용 전자제품 1,600억불, 가전제품 1,140억불, 유무선 기반시설 820억불에 달할 것으로 예상하며 전반적인 반도체 Application별 시장의 꾸준한 성장을 전망하였습니다.

이러한 추세와 IoT, AI, 5G, VR, AR, 빅데이터, 메타버스, 자율주행 및 전기자동차 등 4차 산업 부각에 따라, 각 디바이스에 투입되는 반도체의 유형과 기능이 다양해지면서 반도체 테스트에 요구되는 기능과 특성도 다변화할 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 반도체 테스트 시장의 요구에 LEENO PIN과 IC TEST SOCKET 등으로 적극 대응하여, 신규 IT 시장의 성장과 동행할 것입니다.

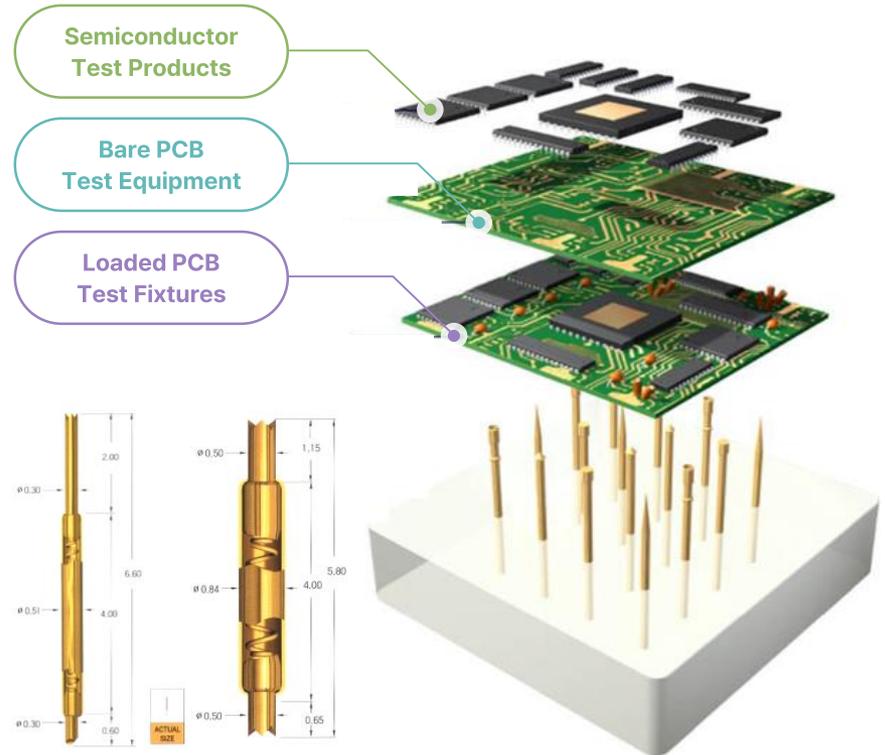
# LEENO PIN

- ☑ 반도체나 인쇄회로기판의 **전기적 불량여부를 체크**하는 소모성부품입니다.
- ☑ Test Probe용 'LEENO PIN'은 당사 자체브랜드로 **국내외 940여 업체**(2024년 매출 기준)가 **사용 중에** 있습니다.
- ☑ 최근 IT부품들의 소형화에 따라 미세화 핀의 수요가 증가하고 있으며, 'LEENO PIN' 사업부문은 **다품종 소량 생산 방식에 특화**되어 있는 기술경쟁력을 바탕으로 **국내 선두의 경쟁력을 유지**하고 있습니다.

## Sales amount

(단위: 억 원)

LEENO PIN(상품 및 2차전지 포함)



# LEENO PIN

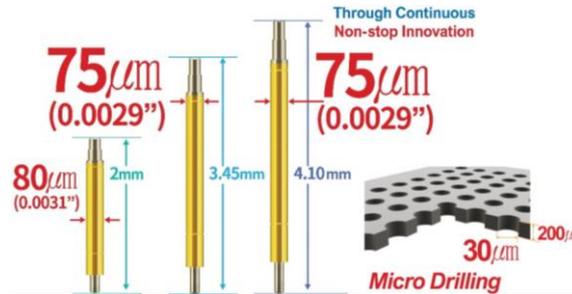
## Spring Contact Probe

LEENO는 맞춤형 디자인 및 100% 내부 생산된 Spring Contact Probe를 최단 납기로 제공할 수 있습니다.



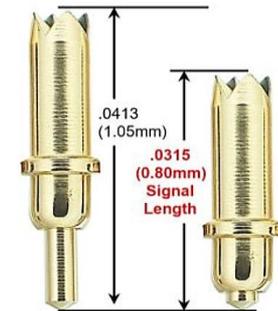
## Fine Pitch Probe

Wafer Level (RF) 테스트 목적으로 특별히 설계된 가장 얇고, 가장 짧은 Fine Pitch Spring Contact Probe를 제공 합니다.



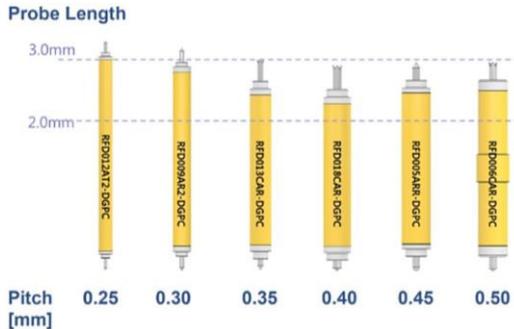
## 0.80mm Probe

High Speed 테스트 목적으로 특별히 설계된 가장 짧은 Spring Contact Probe를 보유하고 있습니다.



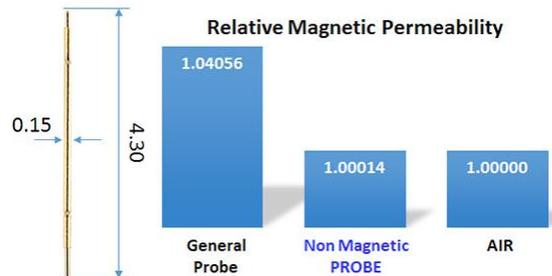
## Coaxial Probe

일반 소켓 하우징에 적용할 수 있는 Coaxial 구조의 Spring Contact Probe를 개발하는데 성공했습니다.



## Non Magnetic Probe

LEENO는 모바일, 자동차, 산업용등의 분야에 사용되는 속도 감지를 포함한 근접스위치, 위치/전류 감지에 사용되는 파인피치 비자성 스프링 개발에 성공하였습니다. 초정밀 기술을 사용하여 네비게이션장치를 테스트하는데 사용할 수 있는 맞춤형 비자성 프로브를 제공합니다.



## ICT Probe

고객의 사양에 맞춘 맞춤형 ICT Probe 뿐만 아니라 1,000개 이상의 표준 모델을 제공함으로써 다양한 선택지를 제공합니다.



# IC TEST SOCKET

- ☑ IC TEST SOCKET은 메모리/비메모리 반도체의 이상 유무를 진단하는 검사장비의 핵심 부품입니다.
- ☑ 글로벌 테블릿PC와 스마트폰의 활황에 따라 비메모리 검사소모품의 수요가 늘어나면서 **지속적인 매출증가 추세**가 이어지고 있습니다.
- ☑ 리노공업은 IC TEST SOCKET의 **지속적인 경쟁력 확보**를 위해 노력하고 있습니다.

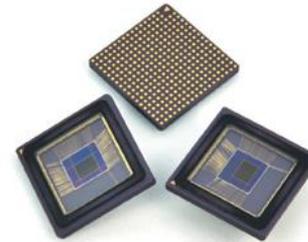
## Sales amount

(단위: 억 원)

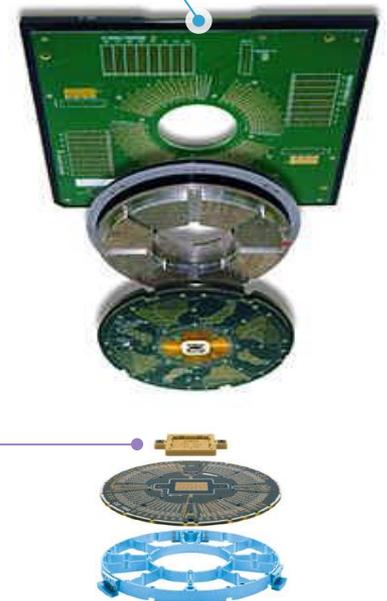
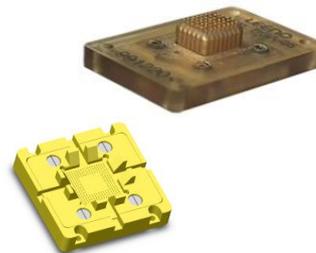
IC TEST SOCKET(프로브 카드 포함)



### BGA반도체



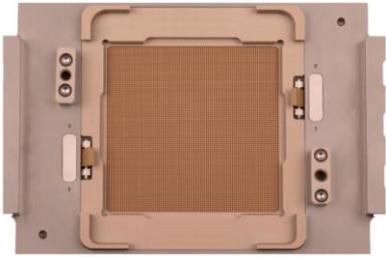
### IC TEST SOCKET



# IC TEST SOCKET

## System Level Test Socket

다양한 디바이스 타입 및 어플리케이션을 위한 대량의 고객맞춤형 System Level Test Socket을 제공하는 검증된 능력을 갖추고 있습니다.



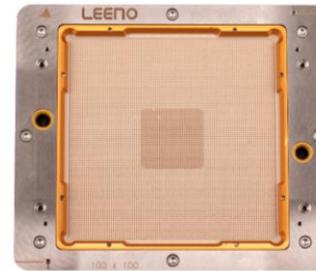
## RF Device Test Socket (Coaxial Socket)

독보적인 소켓 제작 기술력과 혁신적인 동축구조 노하우 그리고 고정밀 가공장비를 보유하여, 높은 대역폭 (100 Ghz), 임피던스 매칭에 대응하는 RF 테스트 소켓을 제공 합니다.



## Large Device Test Socket

FEM 시뮬레이션(구조 변형/스트레스) 및 RF 시뮬레이션(112Gbps/224Gbps)을 통해 large-size 디바이스를 위한 일반/coaxial 테스트 솔루션을 제공할 수 있는 검증된 능력을 갖추고 있습니다.



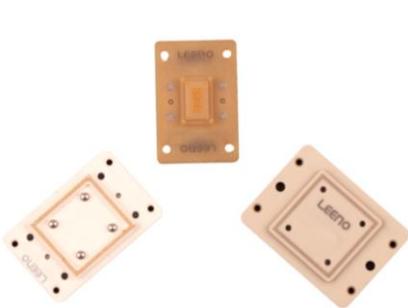
## High Power Cooling Lid

방열 효율을 검증하기 위해 열역학에 대한 쌓아온 지식 및 실제 테스트에서의 방대한 경험을 바탕으로 LEENO는 효율적인 냉각 리드 솔루션을 제공할 수 있습니다.



## Memory Device Test Socket

고성능의 정밀 사출 장비와 특허된 기술을 통하여, LEENO는 모든 종류의 메모리 디바이스용 다양한 테스트 소켓을 제공할 수 있습니다.



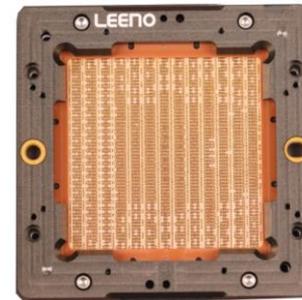
## Elastomer Socket

LEENO는 실리콘 러버 내부에 전도성 입자를 배치한 특별한 구조에 대한 자체 디자인 능력 및 제조 기반을 보유하고 있습니다.



## Strip Test Socket

다양한 디바이스 타입 및 테스트 요구사항에 맞춰 Multi-site Strip Test 소켓을 디자인 하고 제작할 수 있습니다.



## Kelvin Socket

정확하고 안정적인 전압 측정 요구 사항을 충족하기 위해, 저희는 전 세계 다양한 고객에게 Full Kelvin 또는 Mixed Kelvin 소켓을 공급해왔습니다.



# PROBE HEAD(CARD)

- ☑ WAFER상에 구성된 개별 Chip 의 전기적인 특성을 테스트하기 위한 반도체 전 공정 검사장치에 사용되는 부품입니다.
- ☑ 리노공업은 여러 기술의 특성을 고려한 이상적인 PROBE CARD를 제작하여 기술 진화를 선도해 나가고 있습니다.

01

Long life Cycle

02

Quick Delivery

03

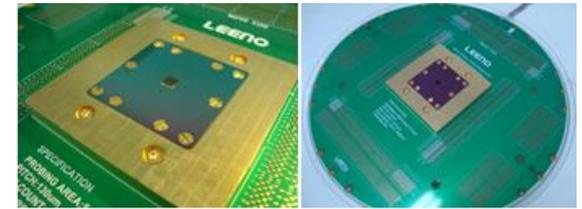
High Speed

04

Low Cost

Semiconductor whole process (FAB)

Wafer level test (LEENO PROBE CARD)



## Sales amount

(단위: 억 원)



## Wafer Level CSP/TSV Probe Card

150 $\mu$ m Pitch Flip Chip Quad Site Vertical Probe Card Total 13,500Pin

Specification	
Minimum Pitch	120 $\mu$ m
Planarity	$\leq 30\mu$ m
Probe Alignment	$\leq \pm 12\mu$ m
Scrub Mark	0~5 $\mu$ m
Tip Length	100 $\mu$ m~500 $\mu$ m $\pm 10\mu$ m Control
Temperature	-20 $^{\circ}$ C~120 $^{\circ}$ C
Probe Depth	6,900 $\mu$ m~12,000 $\mu$ m $\pm 200\mu$ m Control
Contact Resistance	$\leq 0.5\Omega$
Probe Tip Diameter	10 $\mu$ m~100 $\mu$ m Control
Pin Force	2.5g / Mil
Tip Material	Be-Cu(Au Plate) / Pd Alloy

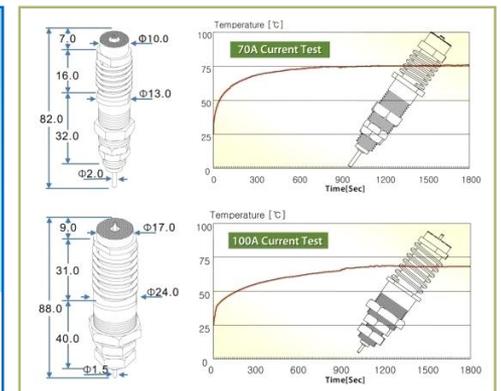
2012" 1Q	
Pin Count	20,000pin
Minimum Pitch	120 $\mu$ m

# Secondary Battery Test Pin

- ☑ '리튬-이온전자'로 대표되고 있는 2차 전지는 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일 기기를 비롯하여 노트북 등 다양한 IT제품에서 빼놓을 수 없는 핵심 부품입니다. 그 뿐만 아니라 2차 전지 시장은 자동차, 에너지 저장 분야에 접목이 가능합니다.
- ☑ 리노공업은 오랜 LEENO PIN 제작경험을 바탕으로, 2차 전지를 최종 소비자가 안전하게 사용할 수 있도록 신뢰성 높은 2차 전지용 TEST PIN을 생산하고 있으며, 적극적인 대응을 하고 있습니다.

## Sales amount

(단위: 억 원)



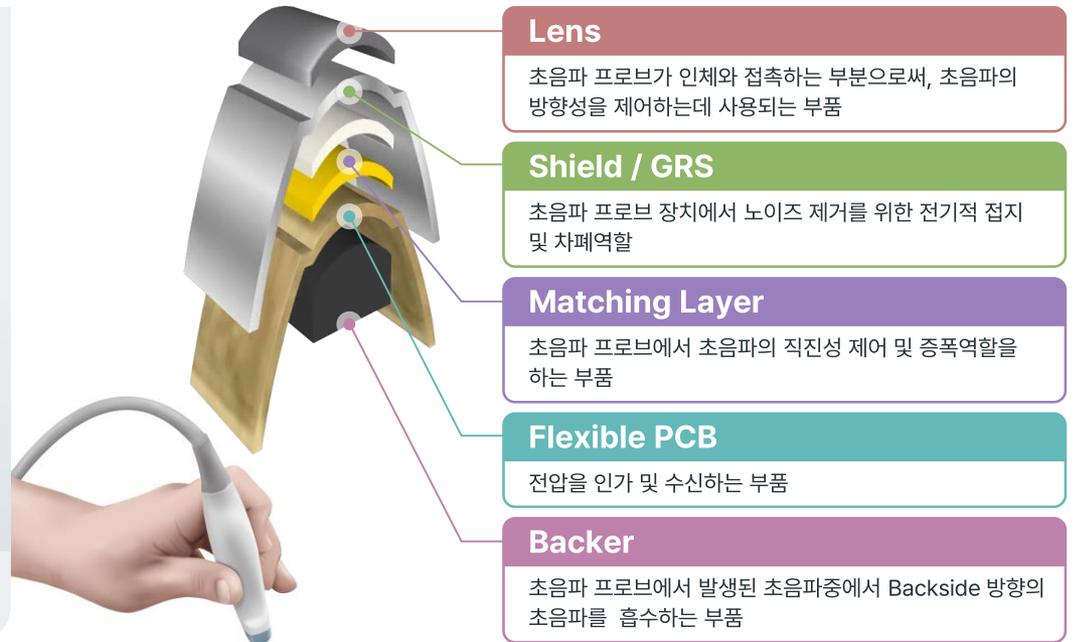
# Ultrasonic wave probe component

- ✓ 2010년 1월 25일, 세계적인 의료기기 제조회사인 **지멘스(SIMENS)**와 **초음파 진단기용 프로브 부품 공급계약을 체결했습니다.**
  - ▶ 초음파 프로브란 ?  
의료기관 등에서 사용되는 초음파 영상진단장치에서 인체와 직접적으로 접촉하여 초음파의 발생 및 검출의 기능을 가지는 일체형 부품
- ✓ 2012년 1월 19일 **의료기기 부품 품질시스템(ISO13485)인증**을 획득하였습니다. (No. 31201901)  
- 인증 범위 : 초음파 프로브 부품의 개발, 생산, 판매
- ✓ **초음파 영상진단장비에 사용되는 핵심부품 등을 제작하고 있으며,**  
이는 높은 부가가치를 형성하는 **신규 성장 동력**으로서 **반도체/전기전자 부문**에 국한되었던 단일 사업구조를 **헬스케어는 물론 에너지 산업, 소비재 산업 분야까지 확대**시킬 것입니다.

## Sales amount

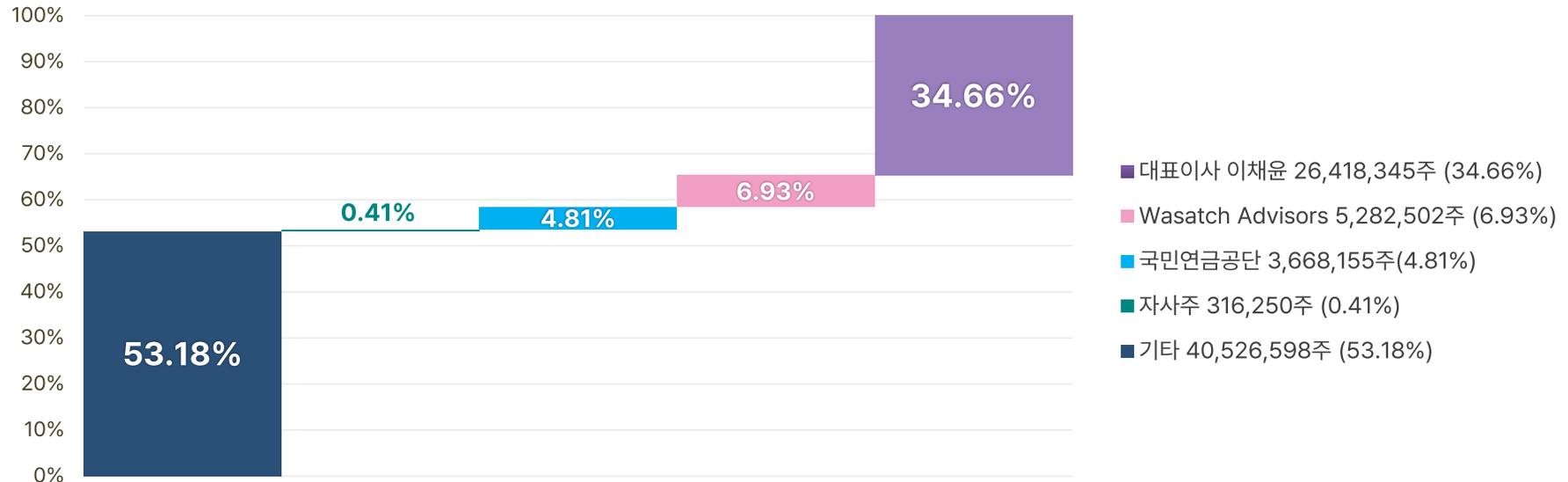
(단위: 억 원)

의료기기(상품 포함)



# Stock Information

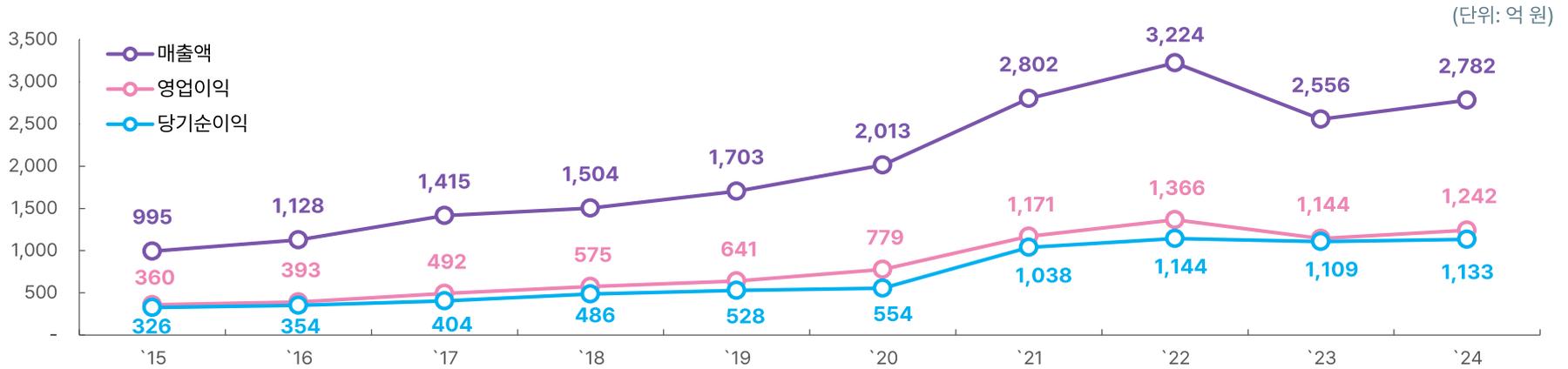
☑ 리노공업은 무차입 경영을 통해서, 주주 여러분과 이해관계자 모두에게 **최대의 가치와 최고의 만족**을 제공하는 노력을 멈추지 않을 것입니다.



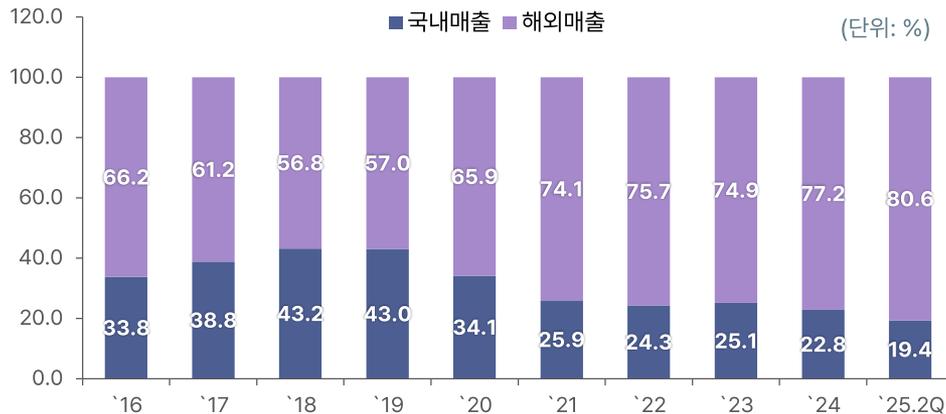
- ▶ 국민연금공단(2025년 3월 19일), Wasatch Advisors LP(2025년 7월 22일) 주식 등의 대량보유상황보고서 공시에 근거하여 작성하였습니다.
- ▶ 자사주 관련하여 2019년 11월 29일 자기주식처분결과보고서 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 주식분할(2025년 2월 11일 주식분할결정 공시 참조)로 인해 총 주식수가 15,242,370주에서 76,211,850주로 변경되었습니다.

# Year Performance

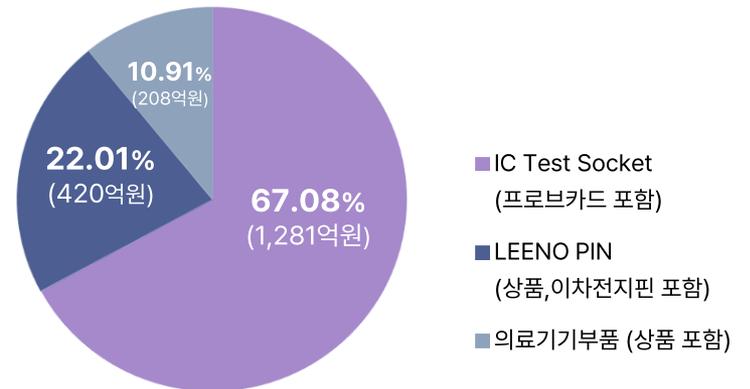
## » Year Performance



## » 내수 및 수출비율



## » 매출구분 ('25.2Q 매출, 1,909억원 기준)



# Dividend

## » 배당금

(단위: 원)

년도	액면가/주당	순 이익	주당순이익	배당금/주당	현금배당수익률(%)	현금배당금총액
`24	500	113,279,046,428	7,463	3,000	1.54	45,537,360,000
`23	500	110,923,015,440	7,308	3,000	1.48	45,537,360,000
`22	500	114,363,791,327	7,534	3,000	1.85	45,537,360,000
`21	500	103,805,815,149	6,839	2,500	1.26	37,947,800,000
`20	500	55,378,772,170	3,648	1,500	1.14	22,768,680,000

▶ 2020년~2024년 배당금 총액은 자기주식 63,250주를 제외한 15,179,120주에 대한 배당금 총액입니다.

### 안정적 경영

- 우량한 재무구조와 현금성 자산
- 무차입 경영상태 유지
- 영업이익 및 순이익 증가
- 고부가 가치의 이익유지



### 주주 환원 정책

# Financial Statement

## » 재무상태표

(단위: 원)

과목	제30기 반기 (당반기)말	제29기 (전기)말
I. 유동자산	476,962,547,883	449,498,090,730
II. 비유동자산	235,204,117,619	207,945,690,026
자산총계	712,166,665,502	657,443,780,756
I. 유동부채	59,577,989,735	30,614,692,642
II. 비유동부채	4,989,141,070	4,199,975,951
부채총계	64,567,130,805	34,814,668,593
I. 자본금	7,621,185,000	7,621,185,000
II. 자본잉여금	5,601,810,444	5,601,810,444
III. 자본조정	(2,353,516,350)	(2,353,516,350)
IV. 이익잉여금	636,730,055,603	611,759,633,069
자본총계	647,599,534,697	622,629,112,163
부채와 자본총계	712,166,665,502	657,443,780,756

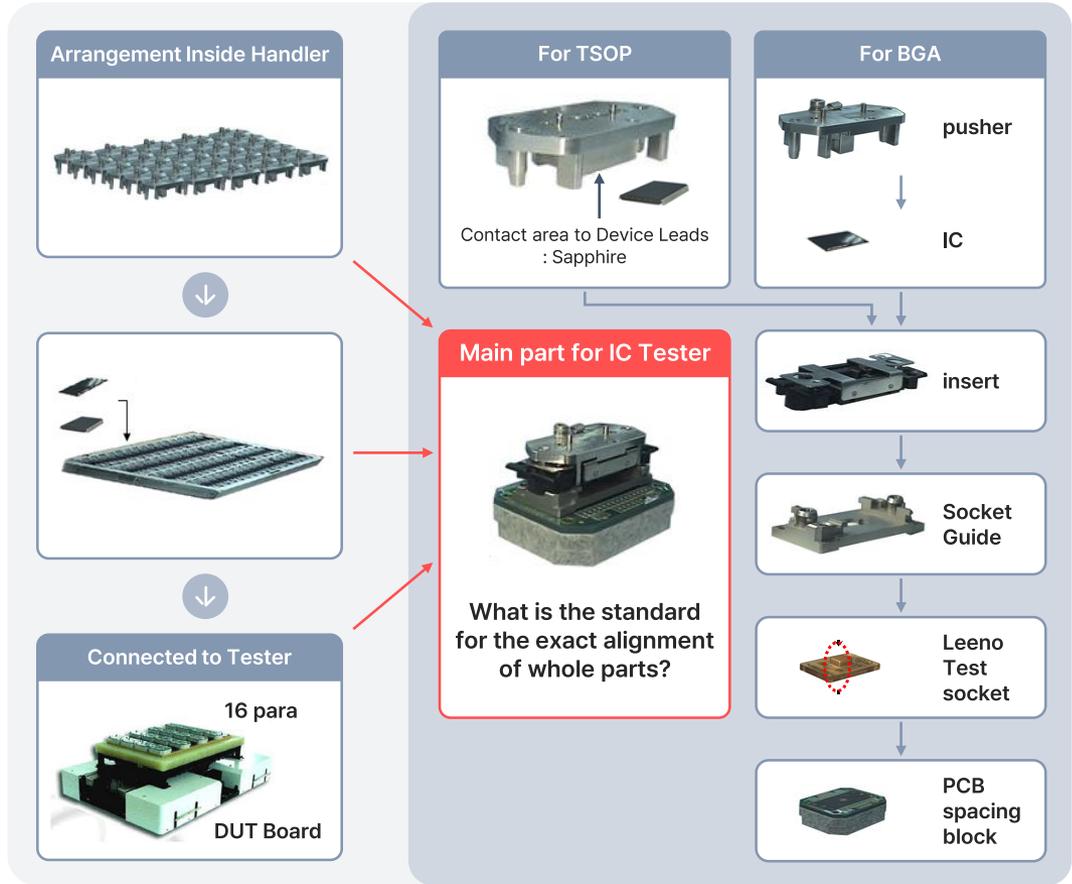
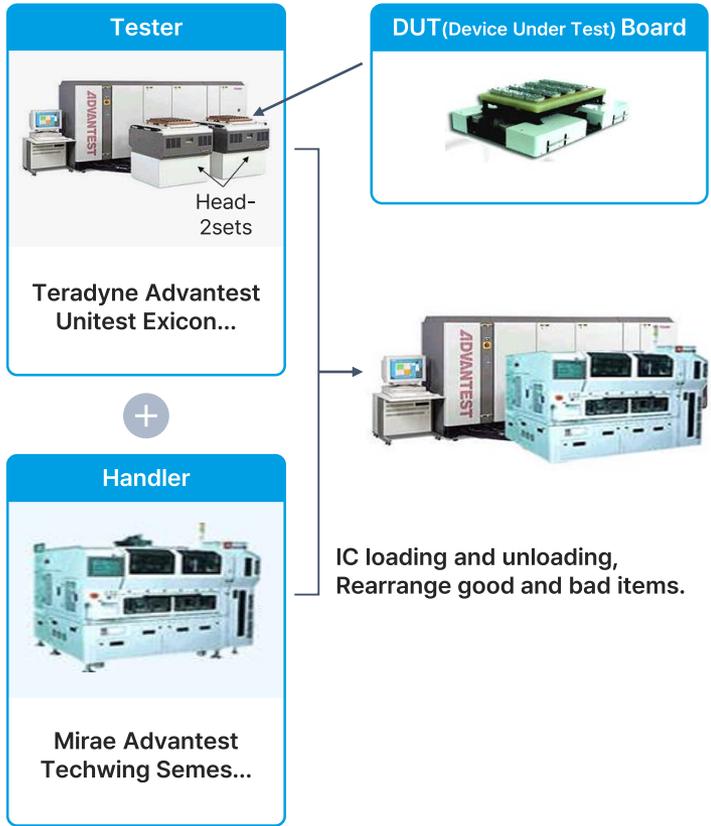
## » 포괄손익계산서(누적)

(단위: 원)

과목	제30기 반기 (당반기)	제29기 반기 (전반기)	제29기 (전기)
I. 매출액	190,932,307,676	125,831,380,988	278,186,189,427
II. 매출원가	93,300,183,598	62,660,952,952	140,020,108,110
III. 매출총이익	97,632,124,078	63,170,428,036	138,166,081,317
IV. 판매비와관리비	9,250,006,717	6,658,655,392	13,964,737,445
V. 영업이익	88,382,117,361	56,511,772,644	124,201,343,872
VI. 영업외손익	2,949,381,540	9,095,906,961	22,337,738,072
VII. 법인세비용차감전이익	91,331,498,901	65,607,679,605	146,539,081,944
VIII. 법인세비용	20,876,850,697	15,157,836,760	33,260,035,516
IX. 당기순이익	70,454,648,204	50,449,842,845	113,279,046,428
X. 기타포괄손익	53,134,330	97,056,565	(2,186,772,331)
XI. 포괄손익	70,507,782,534	50,546,899,410	111,092,274,097
XII. 주당이익			
기본주당이익	928	665	1,493

\* 제29기 기본주당이익은 액면분할에 따라 조정된 기준으로 작성하였습니다.

# Appendix





**THANK YOU**

**LEENO**  
LEENO IND. INC.